

附表五 金屬基本工業、金屬表面處理業、電鍍業和印刷電路板製造業放流水水質項目及限值

項目		限值	備註		
水溫	排放於非海洋之地面水體者	攝氏三十八度以下 (適用於五月至九月)			
		攝氏三十五度以下 (適用於十月至翌年四月)			
	直接排放於海洋者	放流口水溫不得超過攝氏四十二度，且距排放口五百公尺處之表面水溫差不得超過攝氏四度			
氫離子濃度指數		六·0—九·0			
氟鹽		一五			
硝酸鹽氮		五0			
氨氮	金屬基本工業、金屬表面處理業、電鍍業和印刷電路板製造業	排放於自來水水質水量保護區內者	—0		
		金屬表面處理業、電鍍業	排放於自來水水質水量保護區外者	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者	一五0
	中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者		一二0	自中華民國一百一十三年一月一日施行。	
	六0		自中華民國一百一十六年一月一日施行。		
正磷酸鹽 (以三價磷酸根計算)	排放於自來水水質水量保護區內者	四·0			
酚類		一·0			
陰離子界面活性劑		—0			
氰化物		一·0			

油脂（正己烷抽出物）		-0	
溶解性鐵		-0	
溶解性錳		-0	
鎳	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者	0·0三	
	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標，核准排水量大於一百五十立方公尺/日之電鍍業、金屬表面處理業和金屬基本工業，或核准排水量大於五百立方公尺/日之印刷電路板製造業	0·0二	自中華民國一百十年一月一日施行。
	中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者	0·0二	
鉛	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者	一·0	
	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標，核准排水量大於一百五十立方公尺/日之電鍍業、金屬表面處理業和金屬基本工業，或核准排水量大於五百立方公尺/日之印刷電路板製造業	0·五	自中華民國一百十年一月一日施行。
	中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者	0·五	
總鉻	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者	二·0	
	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標，核准排水量大於一百五十立方公尺/日之電鍍業、金屬表面處理業和金屬基本工業，或核准排水量大於五百立方公尺/日之印刷電路板製造業	一·五	自中華民國一百十年一月一日施行。
	中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者	一·五	
六價鉻	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者	0·五	

	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標，核准排水量大於一百五十立方公尺/日之電鍍業、金屬表面處理業和金屬基本工業，或核准排水量大於五百立方公尺/日之印刷電路板製造業	0·三五	自中華民國一百十年一月一日施行。
	中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者	0·三五	
銅	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者	三·0	
	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標，核准排水量大於一百五十立方公尺/日之電鍍業、金屬表面處理業和金屬基本工業，或核准排水量大於五百立方公尺/日之印刷電路板製造業	一·五	自中華民國一百十年一月一日施行。
	中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者	一·五	
鋅	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者	五·0	
	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標，核准排水量大於一百五十立方公尺/日之電鍍業、金屬表面處理業和金屬基本工業，或核准排水量大於五百立方公尺/日之印刷電路板製造業	三·五	自中華民國一百十年一月一日施行。
	中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者	三·五	
鎳	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者	一·0	
	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標，核准排水量大於一百五十立方公尺/日之電鍍業、金屬表面處理業和金屬基本工業，或核准排水量大於五百立方公尺/日之印刷電路板製造業	0·七	自中華民國一百十年一月一日施行。

	中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者	0.七	
硒	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者	0.五	
	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標，核准排放量大於一百五十立方公尺/日之電鍍業、金屬表面處理業和金屬基本工業，或核准排放量大於五百立方公尺/日之印刷電路板製造業	0.三五	自中華民國一百十年一月一日施行。
	中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者	0.三五	
砷	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者	0.五	
	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標，核准排放量大於一百五十立方公尺/日之電鍍業、金屬表面處理業和金屬基本工業，或核准排放量大於五百立方公尺/日之印刷電路板製造業	0.三五	自中華民國一百十年一月一日施行。
	中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者	0.三五	
錫	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標，核准排放量大於一百五十立方公尺/日之電鍍業、金屬表面處理業和金屬基本工業，或核准排放量大於五百立方公尺/日之印刷電路板製造業	二.0	自中華民國一百十年一月一日施行。
	中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者	一.0	
總汞		0.00五	
銀		0.五	
硼	金屬基本工業、印刷電路板製造業	排放於自來水水質水量保護區內者	一.0
		排放於自來水水質水量保護區外者	五.0
	金屬表面處理業、電鍍業	排放於自來水水質水量保護區內者	一.0
		排放於自來水水質	一二

		水量保護區外者	一.0	自中華民國一百十三年一月一日施行。
			五.0	自中華民國一百十六年一月一日施行。
鉬	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者		0.六	自中華民國一百十年一月一日施行。
	中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者		0.六	
硫化物			一.0	
化學需氧量	金屬基本工業、金屬表面處理業、電鍍業		一.00	
	印刷電路板製造業		一.二0	
懸浮固體	金屬基本工業、金屬表面處理業、電鍍業		三.0	
	印刷電路板製造業		五.0	
生化需氧量	印刷電路板製造業		五.0	